

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解貴金属メッキ方法と工程

	[収録年度]	[収録点数]	[CD-ROM版・B5製本版]	[一括購入]
セットA [公開編]	平成15年(1年間)	60点	¥19,215-	¥28,350- (全て税込価格)
セットB [公開編]	平成16年(1年間)	64点	¥20,160-	¥29,400-
セットC [公開編]	平成17年(1年間)	62点	¥19,530-	¥28,350-

		既刊関連セットのご案内		(本体価格)
No,9520	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.13-14	84点 ¥16,800
No,9060	"	"	平.11-12	65点 ¥24,200
No,8593	"	"	平.9-10	62点 ¥23,700
No,8083	"	"	平.7-8	66点 ¥29,500
No,7795	"	"	平.5-6	63点 ¥24,700
No,7552	"	"	平.3-4	57点 ¥23,000
No,7163	"	"	平.1-2	61点 ¥21,000
No,6577	"	"	昭.59-63	64点 ¥21,500
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9	65点 ¥28,000
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点 ¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-12	70点 ¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	71点 ¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点 ¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点 ¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11	103点 ¥35,000
No,9189	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.10-12	68点 ¥24,800
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-12	68点 ¥24,700
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点 ¥23,200
No,9192	"	抗菌性メッキ加工方法と製品	平.9-12	57点 ¥22,800
No,9214	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.10-12	59点 ¥20,900
No,9240	"	電解メッキ用給電装置の構造	平.5-12	103点 ¥30,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

無電解貴金属メッキ方法と工程(セットA・B・C)

No.9997

セットA[公開編] 平成15年 (1年間) 60点 CD-ROM版 ¥19,215 B5製本版 ¥19,215 一括購入 ¥28,350 (全て税込価格)

セットB[公開編] 平成16年 (1年間) 64点 CD-ROM版 ¥20,160 B5製本版 ¥20,160 一括購入 ¥29,400

セットC[公開編] 平成17年 (1年間) 62点 CD-ROM版 ¥19,530 B5製本版 ¥19,530 一括購入 ¥28,350

(セットA)

- 1 無電解ノンシアン金めっき装置用硝子槽 三友エンジニアリング株式会社
- 2 配線基板 京セラ株式会社
- 3 銀鏡用活性化処理剤 株式会社金属化工技術研究所
- 4 光固定された微粒子を触媒とする無電解メッキ法 科学技術振興事業団
- 5 無電解金めっき液および無電解金めっき方法 日本リーロナール株式会社
- 6 置換金メッキ液 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
- 7 配線基板およびその製造方法ならびに電子装置 京セラ株式会社
- 8 電子部品実装基板及びその製造方法 ソニー株式会社
- 9 無電解金メッキ液 日本高純度化学株式会社
- 10 金属配線の製造方法およびその方法を用いた金属配線基板 シャープ株式会社
- 11 金属膜およびその製造方法ならびに積層セラミック電子部品およびその製造方法 株式会社村田製作所
- 12 耐食性複層構造材の製造方法 アラコ株式会社
- 13 無電解金めっき液及び無電解金めっき方法 田中貴金属工業株式会社

以下47点省略

(セットB)

- 1 メッキ調仕上げ物品及びメッキ調仕上げ方法 関西ペイント株式会社
- 2 無電解金めっき液及び無電解金めっき方法 日立化成工業株式会社
- 3 ガラス基板に導電回路を形成する方法 酒井 泰三郎
- 4 プリント回路基板及びそのメッキ方法 三星電機株式会社
- 5 フレキシブルプリント配線基板並びに無鉛半田付け方法 株式会社フジクラ
- 6 電池電極 上村工業株式会社
- 7 はんだ付け用フラックス及び電子回路 ハリマ化成株式会社
- 8 回路パターン形成方法 株式会社大和化成研究所
- 9 白色粉体およびその製造方法 日鉄鉱業株式会社
- 10 無電解めっき方法、及び無電解めっき装置 凸版印刷株式会社
- 11 銀コートフレーク銅粉及びその銀コートフレーク銅粉の製造方法並びにその銀コートフレーク銅粉… 三井金属鉱業株式会社
- 12 無電解金めっきの前処理方法、配線基板及びその製造方法 日本特殊陶業株式会社
- 13 無電解めっき方法 東レエンジニアリング株式会社
- 14 配線基板 京セラ株式会社

- 15 導電性無電解めっき粉体及びその製造方法 日本化学工業株式会社
- 16 導電性高分子上への金属粒子の光析出方法 独立行政法人 科学技術振興機構
- 17 無電解金めっき液 奥野製薬工業株式会社
- 18 メッキ方法 ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.
- 19 メッキ方法 ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.

以下45点省略

(セットC)

- 1 めっき方法、及び電子部品の製造方法 株式会社村田製作所
- 2 ピアインパッド構造の半導体搭載用プリント配線板 日本サーキット工業株式会社
- 3 高分子電解質構造体への導電性金属パターン形成方法及び当該形成方法… 独立行政法人産業技術総合研究所
- 4 多層配線構造の製造方法 株式会社半導体理工学研究センター
- 5 無電解メッキ用前処理液及び無電解メッキ方法 東京エレクトロン株式会社
- 6 銀めっき液 四国化成工業株式会社
- 7 半導体装置の製造方法及びその装置 株式会社荏原製作所
- 8 導電層の製造方法、導電層を有する基板、および電子デバイス セイコーエプソン株式会社
- 9 非導電性多孔質基材の無電解メッキによるパラジウムと銀の同時成膜方法 独立行政法人産業技術総合研究所
- 10 無電解金めっき方法 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
- 11 金属と光触媒粒子との複合材及びその製造方法 小浦 延幸
- 12 光析出による金メッキ法及び金メッキ膜形成装置 市村 正也
- 13 無電解めっき用パラジウム触媒液及び触媒化処理方法 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
- 14 無電解めっきの前処理用組成物 奥野製薬工業株式会社
- 15 低温凝縮型の水電解装置及びこれを利用した質量分析の前処理方法 スガ試験機株式会社
- 16 繊維、繊維束や糸などのめっき方法と装置 名古屋メッキ工業株式会社
- 17 無電解金めっき液 エヌ・イーケムキャット株式会社
- 18 繊維用の無電解銀めっき液 名古屋メッキ工業株式会社
- 19 多孔質シリコン構造体の製造方法および金属担持多孔質シリコンの製造方法 財団法人理工学振興会
- 20 半導体装置の製造方法および製造装置 松下電器産業株式会社
- 21 DNAの無電解メッキによる金属細線構造の構築 独立行政法人科学技術振興機構
- 22 マグネシウム合金基材及びその製造方法 株式会社日鉱マテリアルズ

以下40点省略